

证券代码：301369

证券简称：联动科技

佛山市联动科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：投2025-002

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 电话会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国海证券 杜先康、李亦桐
时间	2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30-15:30
地点	公司会议室电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 邱少媚
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 公司成立于1998年，一直专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售，主营产品包括半导体自动化测试系统、半导体激光打标设备及其他机电一体化设备等。公司的半导体自动化测试系统主要用于检测晶圆以及芯片的功能和性能参数，包括功率半导体的测试、模拟类及数模混合信号类集成电路的测试；激光打标设备主要用于半导体芯片的打标。 公司于2001年推出首台激光打标设备，于2003年公司成功研发出首台半导体分立器件测试系统，于2013年推出集成电路测试系统。鉴于公司在激光打标设备领域积累了丰富的客户资源、封测产线应用经验以及自动化控制技术，经过大

	量的研发投入、实验验证和应用积累，公司逐步切入半导体自动化测试领域，公司的技术路线从半导体激光打标技术外延到了半导体自动化测试技术。发展至今，公司目前已经拥有自主研发的功率半导体及小信号分立器件测试系统产品包括QT-3000/4000/6000/8400系列和集成电路测试系统QT-8000系列等产品，在研的新产品主要为SOC大规模集成电路测试系统。 二、问答环节 1、请问公司对目前行业有什么看法？ 回复：2024年全球半导体行业在经历周期性调整后，虽然面临宏观经济挑战和地缘政治紧张局势的影响，但是新兴技术的快速发展也为行业带来了新的机遇。受益于人工智能、汽车电子、工业物联网、消费电子需求回暖趋势推动，行业呈现逐步复苏态势。当前功率半导体市场持续扩容，受汽车、工业自动化、消费等领域的智能化、数字化市场需求的持续带动，功率半导体市场规模快速增长。碳化硅作为第三代半导体材料的典型代表，具有高禁带宽度、高电导率、高热导率等优越物理特征，在新能源汽车、新能源发电、轨道交通、航天航空、国防军工等领域应用潜力巨大。随着产业链规模化降本、产能扩张及技术创新催生的新应用场景不断涌现，该领域市场空间将持续拓展。与此同时，AI应用带动的消费类电子、车规级半导体测试需求快速增长，叠加SiC、GaN等第三代半导体材料在功率半导体领域渗透率提升，将带动功率半导体、模拟信集成电路以及数字集成电路测试设备需求进一步放量。 2、请介绍下公司现有产品所处市场景气度的趋势？ 回复：目前随着国内外8寸碳化硅晶圆在产能建设、良率、技术突破等方面的进一步突破，下游电动车、储能和光伏新能源以及工控领域在碳化硅模块国产化率的提升，都将推动
--	--

	晶圆测试、KGD测试以及模块测试环节的需求。此外，公司在氮化镓测试技术也具有丰富的储备，针对氮化镓晶圆和器件的QT-8400系列测试设备已批量出货。未来，消费类电子的复苏和多元化的应用也有利于公司模拟测试设备的市场开拓。公司通过战略聚焦与市场拓展双轨驱动，持续深耕大功率器件、模块及第三代半导体测试领域，与国内外头部企业保持深度合作，巩固存量订单、拓展新客户。 3、公司主要的客户有哪些？ 回复：公司持续深耕大功率器件、模块及第三代半导体测试领域，依托国内领先的技术研发能力，通过战略聚焦与市场拓展双轨驱动，成功实现业务规模与客户质量的同步提升。公司不仅与安森美集团、力特半导体、威世集团等国际头部企业及中国中车、三安光电、芯联集成、华润微、通富微电、华天科技、扬杰科技等本土领军企业保持深度合作，更成功突破多家芯片设计厂商的供应链体系，客户结构持续优化。公司近几年自主研发的QT-8400系列测试平台在碳化硅/氮化镓等第三代半导体晶圆及模块全性能测试领域形成技术壁垒，量产出货加速，客户数量稳步增长。 4、公司的新产品目前有什么进展？ 回复：公司正在全力推进SoC类大规模数字集成电路测试领域的新产品的研发和验证工作，该新产品验证周期较长，尚未量产。公司积极拓展测试新应用领域，为后续的业务发展奠定坚实基础。后续进展敬请关注公司在指定信息披露媒体发布的公告。 5、公司的主要业务构成？ 回复：公司的主要业务聚焦在半导体自动化测试系统（测试机），约占公司营收的90%，包括了功率半导体和模拟信号集成电路测试系统。
--	---

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 8 日